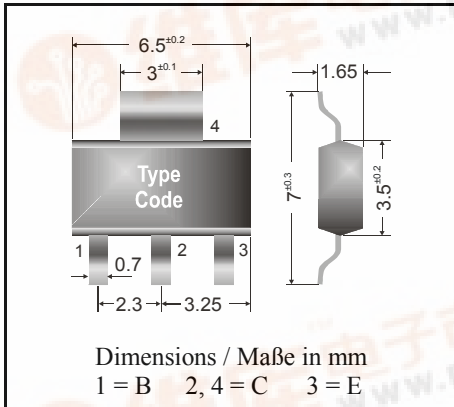


NPN

Surface mount Si-Epitaxial Planar Transistors
Si-Epitaxial Planar Transistoren für die Oberflächenmontage

NPN



Power dissipation – Verlustleistung 1.3 W
Plastic case SOT-223
Kunststoffgehäuse
Weight approx. – Gewicht ca. 0.04 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

			BSP 40 BSP 41	BSP 42 BSP 43
Collector-Emitter-voltage	B open	V_{CE0}	60 V	80 V
Collector-Base-voltage	E open	V_{CB0}	70 V	90 V
Emitter-Base-voltage	C open	V_{EB0}	5 V	
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	1.3 W ¹⁾	
Collector current – Kollektorstrom (dc)		I_C	1 A	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		I_{CM}	2 A	
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		I_{BM}	200 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	- 65...+ 150°C	

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

		Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom $I_E = 0, V_{CB} = 60\text{ V}$	I_{CB0}	–	–	100 nA
	I_{CB0}	–	–	50 μA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom $I_C = 0, V_{EB} = 5\text{ V}$	I_{EB0}	–	–	100 nA
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungsspg. ²⁾	V_{CEsat}	–	–	250 mV
	V_{CEsat}	–	–	500 mV



1) Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal

Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß

2) Tested with pulses $t = 300\text{ us}$ duty cycle $< 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t = 300\text{ us}$ Schaltverhältnis $< 2\%$

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

		Min.	Typ.	Max.	
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ¹⁾					
$I_C = 150\text{ mA}, I_B = 15\text{ mA}$	V_{BEsat}	–	–	1 V	
$I_C = 500\text{ mA}, I_B = 50\text{ mA}$	V_{BEsat}	–	–	1.2 V	
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾					
- $V_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$	BSP 40 BSP 42	h_{FE}	10	–	–
- $V_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 100\text{ mA}$		h_{FE}	40	–	120
- $V_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 500\text{ mA}$	BSP 41 BSP 43	h_{FE}	30	–	–
- $V_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$		h_{FE}	30	–	–
- $V_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 100\text{ mA}$		h_{FE}	100	–	300
- $V_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 500\text{ mA}$		h_{FE}	50	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
$V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$	f_T	100 MHz	–	–	
Thermal resistance – Wärmewiderstand					
junction to ambient air – Sperrschicht zu umgebender Luft		R_{thA}	93 K/W ²⁾		
junction to soldering point – Sperrschicht zu Lötpad		R_{thS}	12 K/W		
Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren		BSP 30, BSP 31, BSP 32, BSP 33			

¹⁾ Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

²⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß